



瑞耘科技
CALITECH

CALITECH

~ Quality Engineering Manufacturing & Services Are Our Commitments ~

內容

壹、公司簡介

貳、市場概況

參、經營模式與競爭策略

肆、經營概況及成長動能

壹、公司簡介

公司基本資料

- 創立時間: 1998年 03 月
- 資本額: 新台幣二億八千七百萬元整
- 董事長: 呂學恒
- 主要產品: 半導體設備零組件及系統設備
- 員工人數: 120 人

瑞耘之願景



持續的研究發展以成爲世界級的半導體及其他高科技製造
領域之關鍵零組件及系統設備的製造及服務商

高科技領域定義: 以半導體製程技術爲主軸及其衍生應用製造產業,如先進封裝, 微機電,
LED,功率晶體,三五族通訊,面板,太陽能等



CALITECH

~ Quality Engineering Manufacturing & Services Are Our Commitments ~

Key Milestones

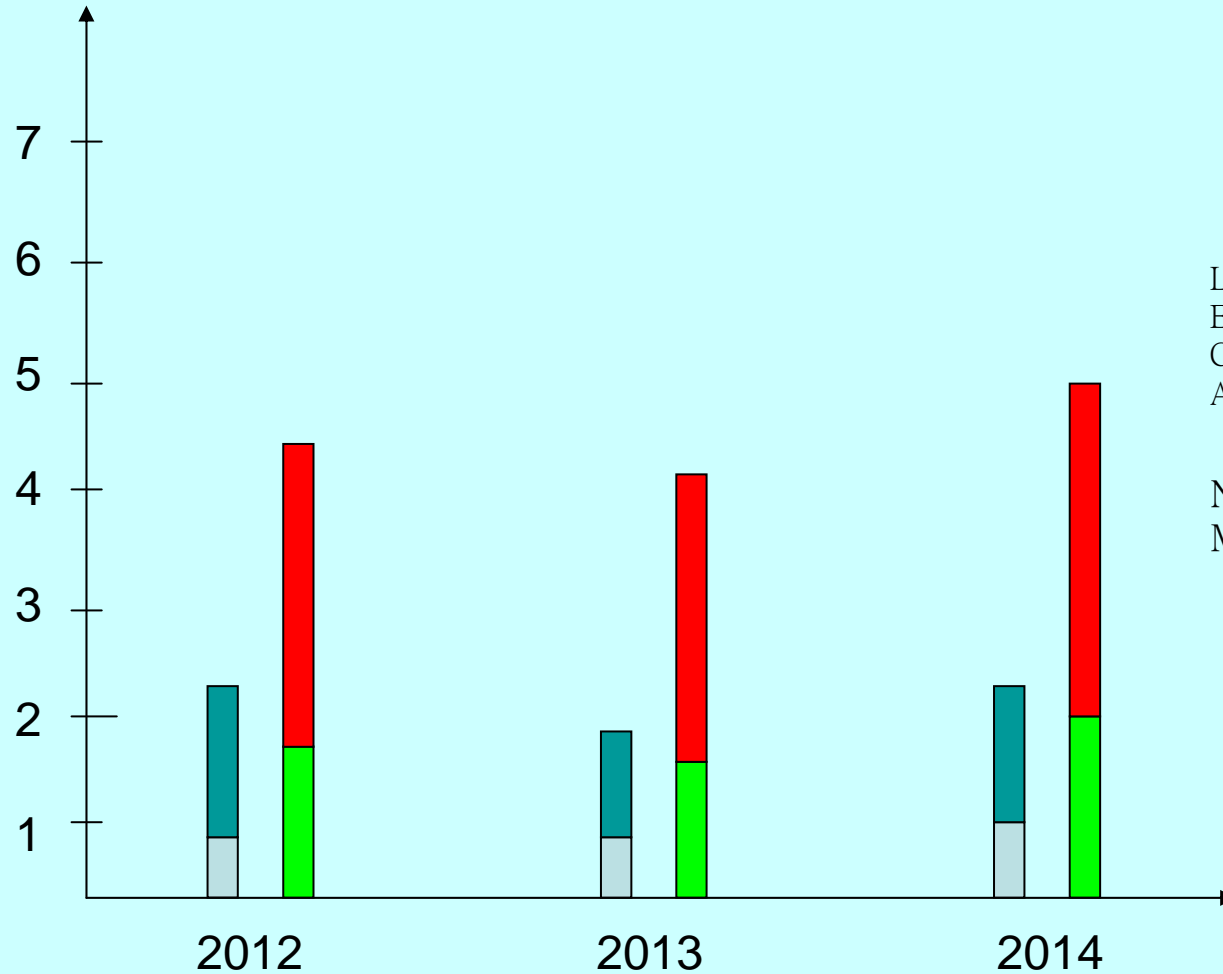


貳、市場概況

半導體零組件代工市場規模



Billion USD



- AMAT AGS
- AMAT SSG
- AM Worldwide
- Total Worldwide

Limited to Semiconductor
Etch/CVD/PVD/CMP/FEP,
Cover
AMAT/TEL/LAM/HITACH/ASM/ULVAC,...

Not include
MEMS/Advanced Packaging/LED/.

市場機會



瑞耘已取得主流供應鍊的門票,並鎖定約800M USD/year
OEM 零組件市場(全球零組件市場規模約5B USD以上)

Semiconductors/Advanced Package/LED/MEMS/..

先進設備亞洲釋單

1. >60K台(6吋及12吋)半導體前段製程設備被安裝其中80%集中於亞太區
2. 年複合成長5%
3. 關鍵零組件智財權為各大設備廠的保密核心,台灣相對較其他區域重視

政府及產業政策

1. 「半導體製程設備暨零組件躍升計畫」,政府積極推動設備關鍵模組及耗材零組件開發
2. TSMC近年對國內本土設備或零件耗材供應商釋出訂單,產業發展的重要性正持續提昇

由競爭轉合作

1. 與美系設備大廠合作,於2013年取得High IP供應商資格,也是高階零組件及區域性技術及策略夥伴地位
2. 取得共同開發關鍵組件的資格,如晶圓靜電吸盤/加熱器..等

瑞耘核心能力

1. 垂直整合技術及製造
2. 材料、表面處理及接合技術,領先其他同業
3. 完成陶瓷噴塗及鋁合金真空硬焊技術開發

Corporate Mission

Leading Provider of parts/components solution
to the world!

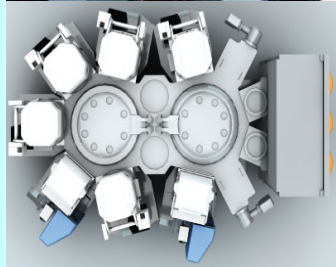
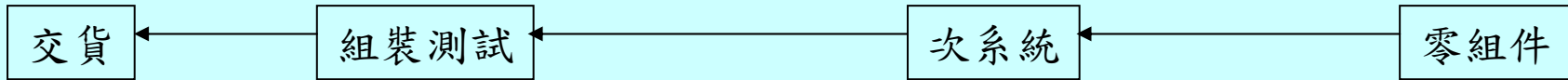


UMC



參、經營模式與競爭策略

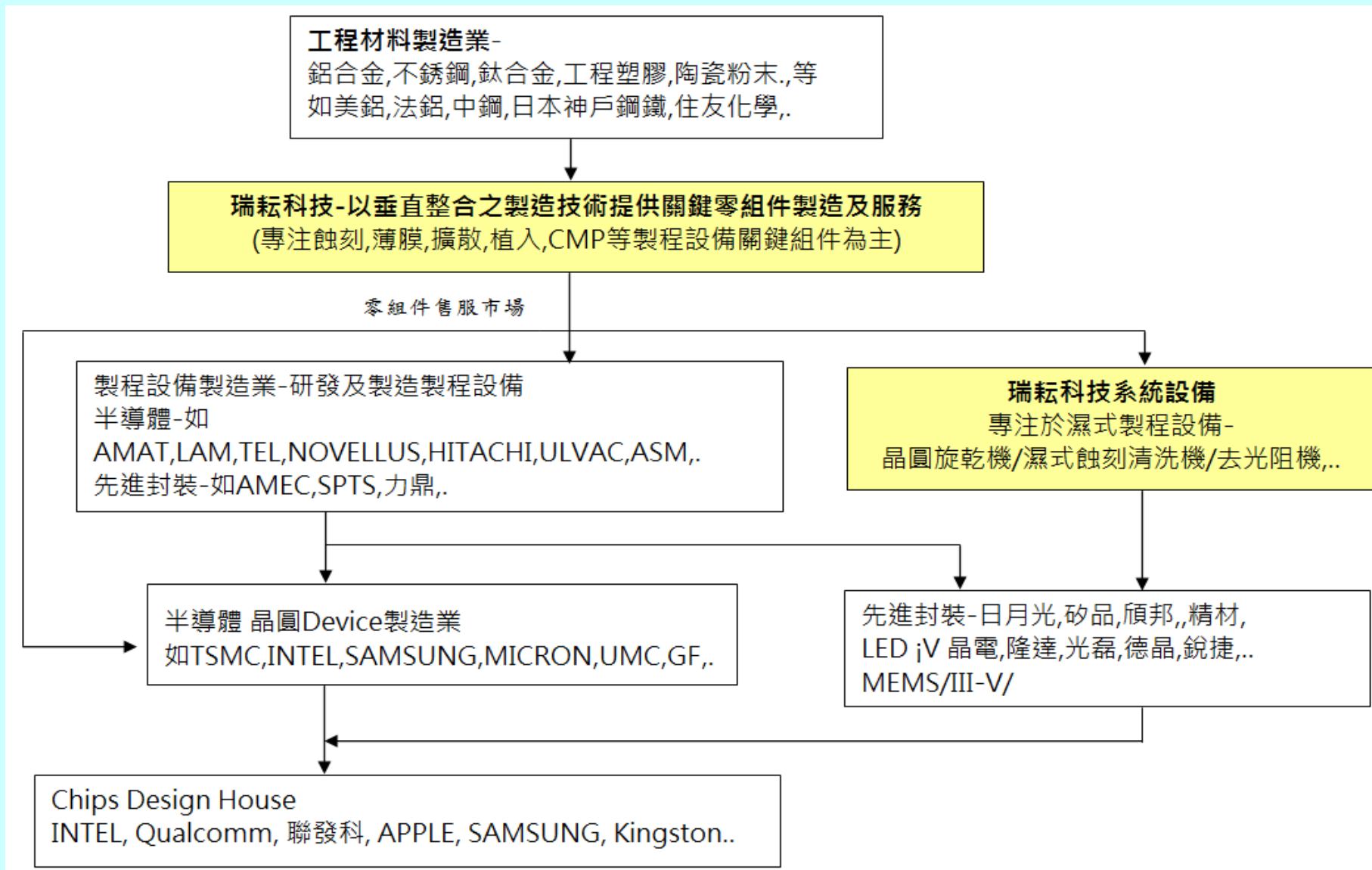
半導體設備生產鏈



製程腔零組件

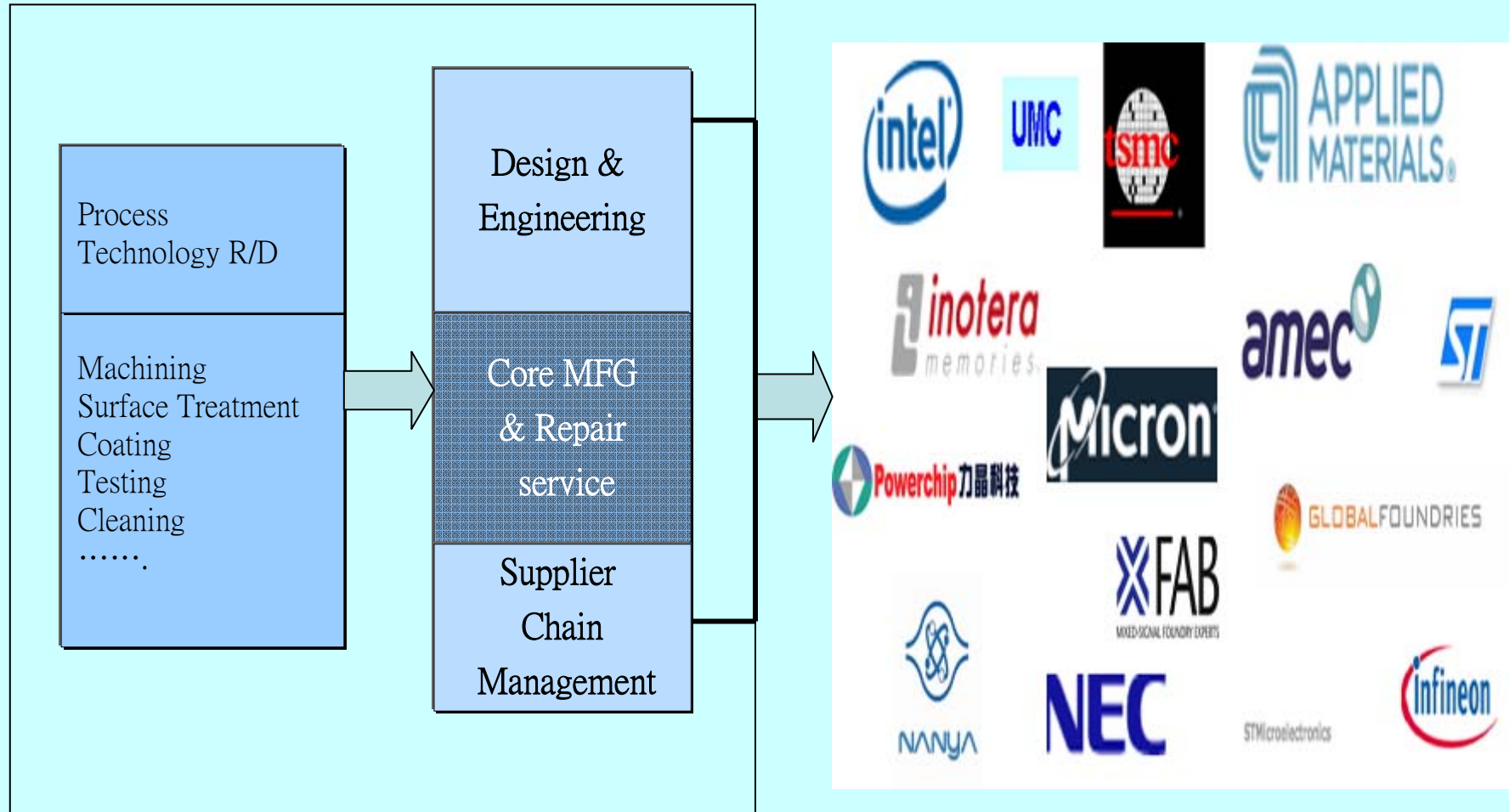


上下游關聯圖



Partners and Solutions

CALITECH



競爭利基

優勢

全球高階製程設備關鍵零組件認證

- 1.取得美系半導體設備商高階製程產品認證與多項共同開發案
- 2.產品行銷無區域限制
- 3.擁有國際客戶認可之品保系統



成長動能

產品
覆蓋率高

年成長
20-25%

核心技術

一條龍的垂直技術整合及製造服務

- 1.材料、表面處理及接合技術,領先其他同業
- 2.整合重要技術與製程;提供one shop服務方案
- 3.噴塗硬焊技術開發完成



成本優勢

- 1.產品製程品質控制一致性高
- 2.產品準時達交率高
- 3.協助客戶節省物流成本

零組件競爭分析

WIN!

CALITECH

採垂直整合方式進行ESC研發
佈局,產業應用面廣

掌握最新技術,OEM品質認證
行銷不受區域局限,創造三贏

High IP 專業廠
製程技術整合,生產具成本優勢

專注腔體內關鍵零組件
區隔競爭市場

ESC專業廠,專注前段,成本結構高

培養單一產品及技術供應鏈,國際
行銷難

Low Cost Region 以機加工為主,製
程整合度低

Contract Manufacturer OEM-
以系統統包訂單為主

系統設備競爭分析

WIN!

CALITECH

SRD市場佔有領先,並取得CE認證,
逐步建立歐美日等區域行銷網

SRD 台灣 中國競爭對手
產品規範及認證未取得

深耕亞太市場,成本優勢,並逐步建
立高階設備SST/SAT客服能力

SAT/SST 國外競爭對手
價格高,海外客服能力弱

專注中小尺寸批次生產機台
區隔市場

濕式製程設備商- AutoBench,
國內廠商
專注先進封裝批次及單片濕式製程

競爭策略

零組件

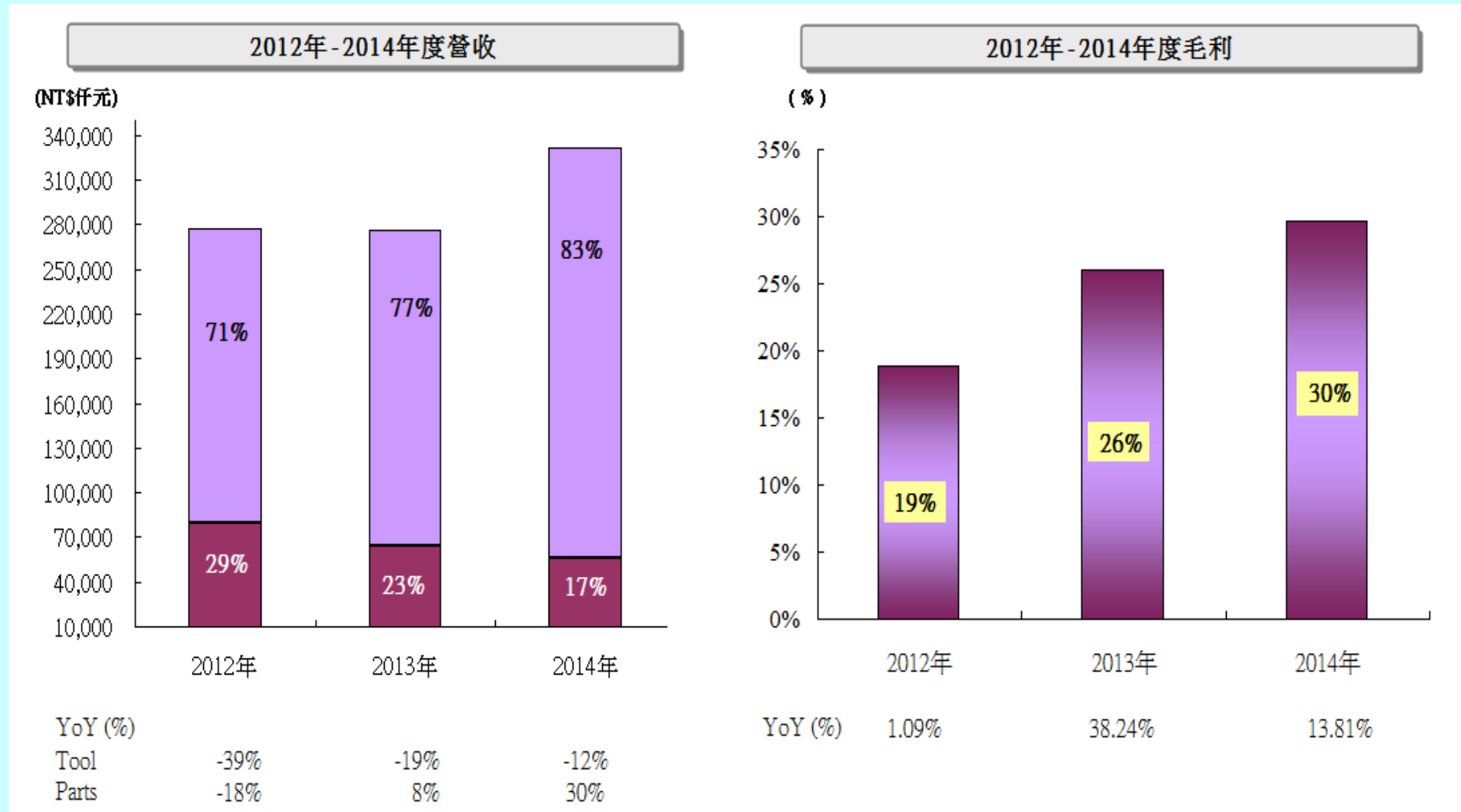
1. 專注關鍵零組件研發及產品製造整合
2. 逐步擴展ESC/Heater行銷, 進入新藍海
 - (1) ODM 共同研發
 - (2) 非半導體新應用領域

系統設備

1. 專注批次製程技術逐步往單晶片機台開發
2. 保持SRD市佔率領先及擴大海外佔有率
 - (1) 除LED外, 延伸至MEMS、CMOS、先進封裝、類比/Power IC等客戶, 保持市佔率領先
 - (2) 透過區域性代理商及協助建立售服能力

肆、經營概況及成長動能

Revenue Momentum & Healthy Gross Margin



成長動能



以靜電吸盤/加熱器為核心產品,在先進封裝,微機電,自動化領域,開創先機與藍海

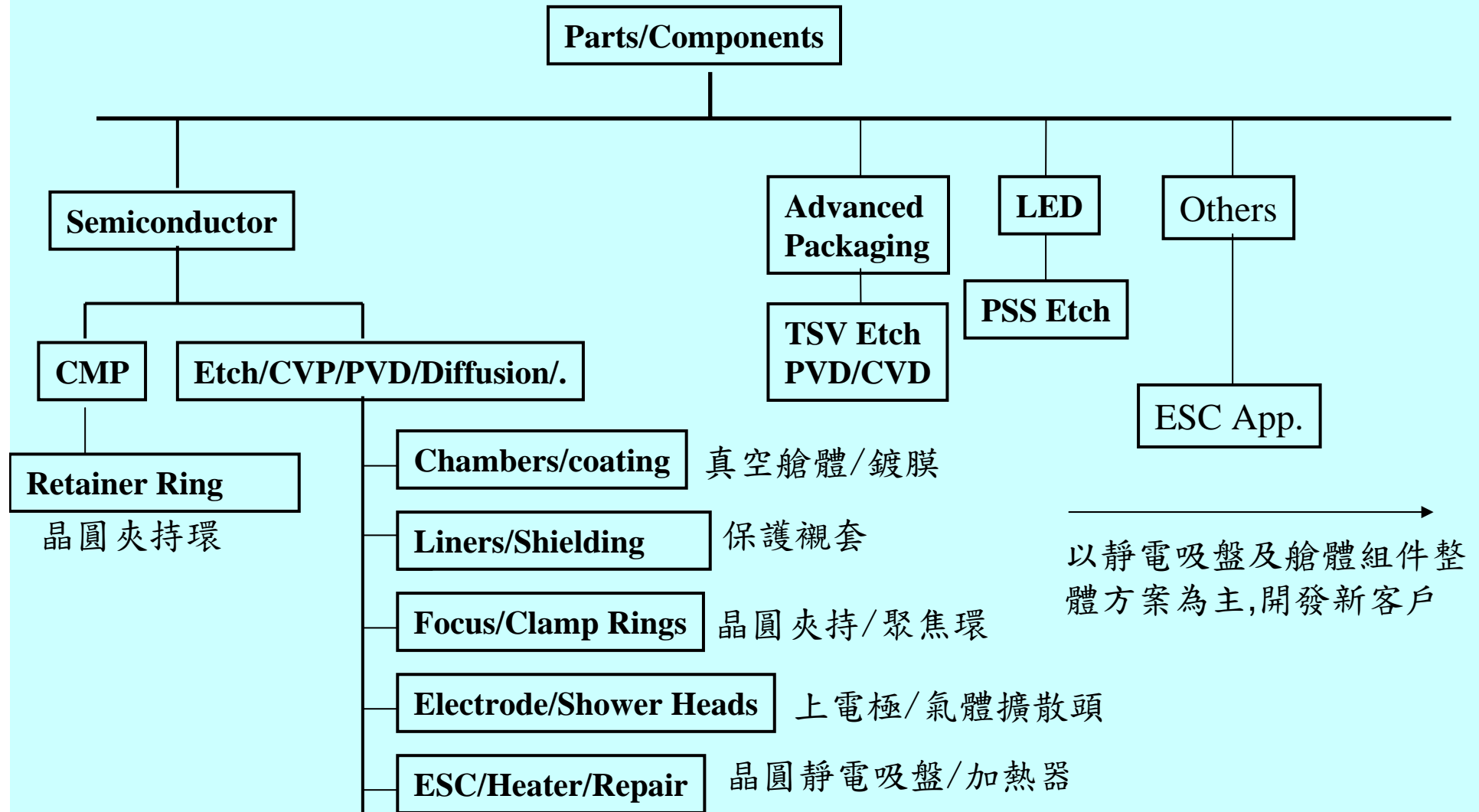
在產業往亞太釋單趨勢下,鎖定核心技術及產品,橫向拓展其他OEM/ODM客戶

- 1.配合OEM供應鏈移轉計畫,通過核心技術認證,提升營運績效
- 2.爭取國際設備大廠共同研發專案,尤其是靜電吸盤/加熱器產品
- 3.配合客服,提供即時改善/維修服務方案



Appendix: Our Products

零組件產品與製程關係圖



敬請指教!